

ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課
Indonesia Factory, Quality control section,
Hirose Electric Co., Ltd.

工程変更連絡書 Process Change Notice

承認 Approval	査閲 Review	作成 Created by
Sasaki	Liska	Tety

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。

本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後、2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。

We truly appreciate your significant support always.

We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.

Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.

貴社品番/Product number of your company	弊社品番/Product number by Hirose 別紙参照 see attachment file	弊社品名/Product name by Hirose TMシリーズ品 別紙参照
-------------------------------------	--	---

Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	端子金型の変更 / Die contact change	理由 Reason	金型老朽化の為です/ Die contact aging
	変更 2	区分 Type	端子金めっき範囲の変更 Plating contact area change	理由 Reason	金めっき不要部のめっき加工を省くためです To eliminate plating process for parts area that do not require with gold plating.
	変更前 Before the change		変更後 After the change		影響範囲 The scope that will be affected.
	〔端子〕 ① 現行金型での生産 ② プラグ端子接触エリア外の金めっき ① Current Die ② Gold plating in the other contact side area		〔端子〕 ① 更新金型での生産 ② プラグ端子接触エリアのみ金めっき ① Renewal Die ② Gold plating only in contact area		設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and Performance. 外観の変更 Appearance 有 Change 含有物質変更 Containing substance 無 No change

Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	10/3W	10/4W	11/1W	11/2W	11/3W	11/4W						
	工程整備 Preparation of process	➡											
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	➡											
	トライ Trial		➡										
	作業教育 Education on operators		➡										
	製品評価試験 Product evaluation test			➡									
	サンプル提出 Submission of sample				➡								
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result					➡							

量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2021年 12月M予定 Scheduled on 12/2021	備考
---	--------------------------------------	----

変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2021年 11月 20日 20/11/2021	Remarks	
---	-----------------------------	---------	--

Issue No. / 発行No. : PC-0018195

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.		貴社名/Your company name	
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	TMシリーズ品 別紙参照 TM series see attachment file	ご判定日/Judgment day
	変更内容 Content of change :	① 端子金型の変更 / Die contact change ② 端子金めっき範囲の変更 Plating contact area change	ご担当者/Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			

別紙 「対象品リスト」 Item list

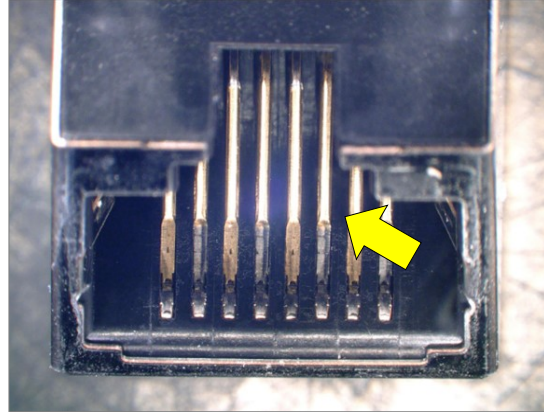
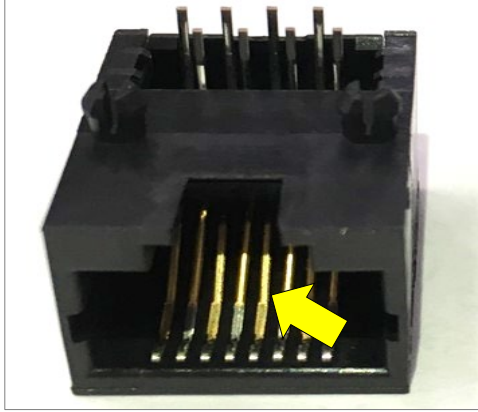
No.	Item code	Item name
1	222-2665-8 40	TM5RL-88(40)
2	222-2666-0 40	TM5RLF-88(40)
3	222-2667-3 40	TM11R-5L-88(40)
4	222-2667-3 42	TM11R-5L-88(42)
5	222-2667-3 43	TM11R-5L-88(43)
6	222-2668-6 40	TM11R-5LF-88(40)
7	222-2671-0 40	TM5RL-3232(40)
8	222-2711-3 40	TM5RLF-3232(40)
9	222-2720-4 40	TM11R-5L-3232(40)
10	222-2722-0 40	TM11R-5LF-3232(40)
11	222-2935 0 40	TM5RL-88-JJ5E(40)
12	222-3798 7 40	TM5RL-88-JJ(40)
13	222-3798 7 41	TM5RL-88-JJ(41)
14	222-3805 0 40	TM5RLF-88-JJ(40)

— 以 上 —

別紙「変更に伴う外観の変化」

【変更前 Before the change】

プラグ端子接触エリア外まで金めっきがされている Plated area cover over contact point.



【変更後 After the change】

プラグ端子接触エリアのみに金めっきされている Plated area cover contact point.

